

惠骏达供应dek专用刮刀片，激光切割精度高

产品名称	惠骏达供应dek专用刮刀片，激光切割精度高
公司名称	深圳市惠骏达电子材料经营部
价格	30.00/张
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡街道流塘路25号1楼商铺
联系电话	0755-61500552 18938693461

产品详情

PCB板的BGA植球钢片，适用BGA芯片返修，将锡球放置到PCB板BGA上，需要BGA植球钢片辅助完成，锡球一般比BGA焊盘大，因此开孔要大一些。

2、PCB板的BGA印刷钢片，对应BGA焊盘1：1开，有特定尺寸开孔，不会连锡，四边对应夹具切割有定位孔进行夹紧定位。

3、钢网对就的BGA印刷、贴片后有些会返修的BGA、售后要用到单独的BGA印刷、植球钢片，需要单独做钢片、

产品名称：DEK专用刮刀片 使用材料：进口不锈钢

产品规格：20*300mm，20*350mm，30*200mm等任意规格皆可定制

产品厚度：刮锡膏厚度0.2-0.5mm皆可制作 适合：线路板刮锡膏印刷

交期：激光切割速度快，误差小。交期迅速。

订购热线：18938693461